

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	富国基金、永赢基金、招商基金、新华资产、泰康基金、信达澳亚、朱雀基金、中银基金、财通资管、中银资管、兴业基金、东方自营、中信资管、浦银安盛、一创自营、三亚鸿盛、上银基金、中欧瑞博、中邮基金、丹寅私募、测度基金、兆顺基金、东恺投资、稳见投资、信泰人寿、中欧瑞博投资、冲积资产、创金合信、勤辰私募、友邦保险资管、国信自营、国投瑞银、国新证券、宝盈基金、恒越基金、杉树资产、汇安基金、海创私募、淳厚基金、申万菱信、百嘉基金、趣时资产、君诺资本、盘京投资、西部利得、长城基金、长城财富、长盛基金、前海开源基金、老鹰基金、天禧投资、寰宸基金、上海杉玺投资、陕西高新技术产业投资有限公司、长江证券
时间	2026年5月28日
地点	锦州公司总部A座104会议室、武汉光谷会展中心及线上会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司本次计划向特定对象发行A股股票的战略考量</p> <p>2026年第一季度以来，全球消费级存储需求转向中国供应链的趋势明朗，中国本土存储芯片制造厂商的产能扩充和技术发展，在科技巨头资本开支所驱动的人工智能需求之外，获得了全球消费市场更为坚实、持久的支撑。</p> <p>公司认为，中国本土厂商以超大规模国内统一大市场为基础，通过“规模降本-技术迭代-产业链闭环-建立行业标准”的路径，后发先至取得全球产业竞争制高点之范式，在过去十年的LCD面板、光伏、动力电池、碳纤维等领域得到反复验证。因此，中国本土存储芯片制造厂商有望加速成长为世界级公司。</p> <p>相比海外竞争对手数十年乃至上百年的积累而言，包括公司在内的本土半导体材料和零部件企业，普遍设立时间较短、经验有限、资源不足。“如何在短时</p>

间内匹配世界级客户的世界级需求？”既是挑战更是机遇。

接下来几年，所有中国国产存储芯片制造厂的配套供应商，不仅产能方面要紧跟客户实现跨越式发展，生产管理、供应链建设、技术研发、智能化管理水平、资本运作能力乃至企业文化建设，都将受到全方位的挑战。

用进废退，不进则退，产业竞争已经从“资格赛”和“小组赛”，进入到“排位赛”和“淘汰赛”，需要加强行业合作、加大资源投入。

公司的大直径硅材料产品及其制成品硅零部件，是高端存储芯片制造所需等离子刻蚀环节中的核心耗材，开工率越高、刻蚀强度和次数越多，消耗量越大。根据公司自主调研数据，2026年，中国大陆硅零部件市场规模有望达到约70亿元人民币，未来几年内市场规模将超过百亿元。

公司计划通过本次股票发行募集资金不超过10亿元，强化第二曲线、发展第三曲线，稳扎稳打提升内功，力争抓住未来几年中国存储芯片产能大规模建设、国产化率提升的机遇。

二、硅零部件市场发展趋势

除前述国内外存储芯片制造厂商的产能扩张以外，技术发展方面——随着存储芯片先进制程向着3D堆叠方向不断进展，将需要更多高深宽比刻蚀工序；且先进存储芯片电路线宽刚刚突破等效10nm以下，先进逻辑芯片向等效2nm以下迈进，还需要更大直径的硅零部件。

因此，定性来看，伴随产能扩张和技术革新，先进制程逻辑和存储芯片制造厂的刻蚀用量将增长，硅零部件的需求量将增大。

三、碳化硅陶瓷零部件市场规模和发展趋势

碳化硅陶瓷零部件是公司过去数年着力打造的新业务，具备较好的技术和市场积累。

碳化硅陶瓷零部件的应用场景，包括刻蚀、薄膜沉积、外延、离子注入，以及氧化、扩散、退火等热处理工序，因此其应用场景要多于硅零部件，且下游客户与公司硅零部件和硅片产品高度重叠。

目前公司根据自主调研测算，其市场规模大于硅零部件，且国产化率更低、

	<p>交期更长、对下游客户的“卡脖子”风险更大。</p> <p>考虑到中国本土先进存储和逻辑芯片制造厂的产能扩张、开工率提升及技术提升，将对刻蚀、薄膜沉积、外延等工艺提出更高要求，预计碳化硅陶瓷零部件的市场规模和国产化需求将持续扩大。</p> <p>四、关于预案募投项目的拟投资规模</p> <p>根据公开数据横向比较，公司本次预案拟募投项目的投资规模，在硅零部件和碳化硅陶瓷零部件领域都处于国内前列；纵向比较公司在以上产品的历史累计投入，本次拟投资规模也相对较大。以上反映了公司坚定的战略决心。</p> <p>五、公司硅片业务进展</p> <p>第一季度以来，公司硅片业务开工率有所提升。随着下游8吋 Logic/Foundry 市场景气度提升，以及海外竞对退出8吋市场导致的竞争格局改善，公司认为未来硅片业务前景可期。公司未来将聚焦利润水平较高的细分市场，并积极拓展新兴的硅片应用领域。</p>
附件清单	无
日期	2026年5月28日